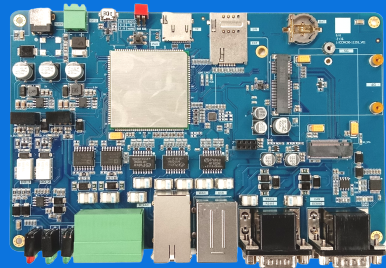


IM500 工业主板



利尔达IM500工控主板基于飞思卡尔i.MX6系列处理器设计，处理器采用Cortex-A7内核，DC9~28V宽压供电，集成了高速DDR存储器和大容量eMMC存储器，集成以太网接口3路（百兆WAN口1路+百兆LAN口2路），USB接口2路，OTG接口1路，RS232接口2路，RS485总线接口4路，CAN总线接口1路，开关量输入2路，温度采集2路，模拟输入2路，继电器输出2路；且兼有PCIE、M.2、NB扩展接口，支持CAT.1、4G、5G、LORA、NB、Zigbee等模块扩展，支持外部插拔SIM卡接口1路，支持外部扩展TF卡接口1路。具有集成度高，扩展性强的特点。支持nfs及ssh协议，可支持远程虚拟连接，可方便的内置MQTT连接服务，对接不同IOTHUB设备。可以方便集成第三方PROFINET和ETHERCAT通讯接口SDK，或通过软件升级支持西门子等专用协议。可广泛适用于各类工业应用场景。



基于飞思卡尔i.MX6
系列处理器设计



DC9~28V宽压供电



外设接口丰富



PCIE、M.2拓展接口

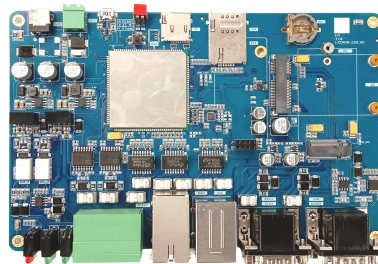


完善的OS和丰富的
外设驱动支持

应用领域



IM500 工业主板



基本参数

CPU	i.MX6ULL, ARMCortex-A7core@792MHz
内存	2G bits DDR3 (可根据需求定制)
存储器	2G bits NAND / 8GB eMMC (可根据需求定制)
操作系统	Linux 4.1.15

其他参数

电源输入	DC9-24V/2A, 防反接, 低压、过压保护
整机功耗	待机功耗: $\leq 3W$; 峰值功耗: $\leq 5W$ 注意: 基于单板环境测试, 配置不同扩展模块时功率会有增加
整板尺寸	190mm*120mm*35mm
工作环境	温度: $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$; 湿度: 10% ~ 90%RH (无冷凝)
存储环境	温度: $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$

接口特性

网络WAN口	1路10/100M
网络LAN口	2路10/100M
USB接口	2路USB2.0HOSTTypeA; 1路OTGMicro (默认Device用于程序下载)
实时时钟	板载RTC, 板载纽扣电池接口
TF卡接口	1路; 自弹式
SIM卡接口	1路; 标准大卡, 自弹式
RS232接口	1路; DB9公头
Debug接口	1路; DB9公头
CAN总线接口	1路; DB9公头
RS485总线接口	4路; 2路DB9+2路3.81端子
开关量输入	2路; 3.81端子; 外接无源开关
温度采集	2路; 3.81端子; 外接NTC电阻
模拟输入	2路, 4~20mA/1~5V输入
继电器输出	2路; 3.81端子; 2A30VDC/0.5A125VAC, 最大切换功率62.5VA/60W
板载PCIE	1路; 支持CAT.1、4G等模块扩展
板载M.2	1路; 支持5G模块扩展
板载扩展接口	1路; 支持LORA、NB、Zigbee等模块扩展

